

INFORMATION MEETING

2004



電子機器の市場環境

● 携帯電話市場

- 高機能化・多機能化(カラー液晶・カメラ・GPS機能搭載)による買い替え需要
- 新興市場(中国・ロシア・インド)での販売台数増加
- 第3世代携帯電話の普及拡大

● パソコン市場

- ノートPCの需要拡大、企業の買い替え需要
- 一層の高機能化(MPU高周波化、無線LAN機能、高速インターフェース、HDD大容量化)による部品需要の拡大

<需要予測(当社推計値)>

(単位:億台)

		2003年度	2004年度	伸率
携帯電話	販売台数	4.9	5.5	13%
	部品需要台数	5.3	6.0	13%
パソコン	販売台数	1.4	1.6	11%
	部品需要台数	1.5	1.6	10%

- デジタルAV機器市場

- DVDレコーダ、PDP・液晶TV、デジタルスチルカメラの需要拡大

＜生産台数予測(当社推計値)＞ (単位:百万台)

	2003年度	2004年度
DVDレコーダ	5	8
PDP-TV	1	2
液晶TV	3	5
デジタルスチルカメラ	45	60

- カーエレクトロニクス市場

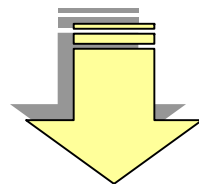
- 電装化の伸展などにより、安定成長が期待される

(ECU(Electronic Control Unit)、RKE(Remote Keyless Entry)、
TPMS(Tire Pressure Monitoring System)、CAN-BUS、
カーナビ、ETC(Electronic Toll Collection))

電子機器の市場環境

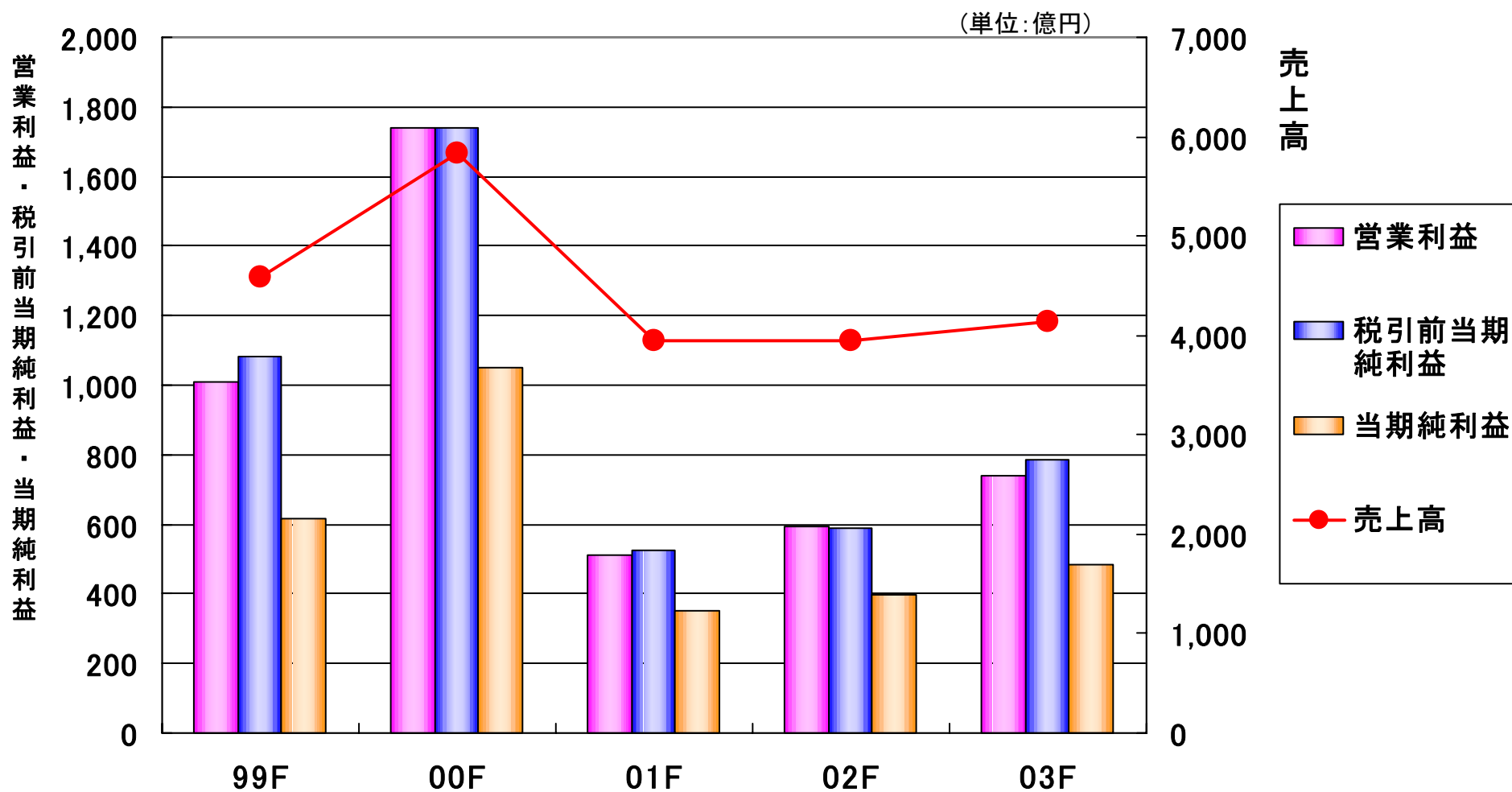
- 電子機器市場は、2000年度以降、長らく成長が鈍化していたが2003年度上期から再び成長軌道に

携帯電話市場
パソコン市場
デジタルAV機器市場
カーエレクトロニクス市場



電子部品需要のすそ野は着実に拡大

売上高及び利益の推移(連結)



2003年度業績概況(連結)

	2002年度	2003年度	増減
売上高	3,950億円 (100.0)	4,142億円 (100.0)	+193億円 (+4.9%)
営業利益	592億円 (15.0)	742億円 (17.9)	+150億円 (+25.4%)
税引前利益	591億円 (15.0)	787億円 (19.0)	+196億円 (+33.2%)
当期純利益	395億円 (10.0)	485億円 (11.7)	+91億円 (+23.0%)

<以下、2003年度の厚生年金基金代行返上による影響額を除いた場合>

	2002年度	2003年度	増減
営業利益	592億円 (15.0)	625億円 (15.1)	+33億円 (+5.6%)
税引前利益	591億円 (15.0)	670億円 (16.2)	+79億円 (+13.4%)

※()内の数値は売上高比または増減率

2003年度業績概況(連結)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上高	935億円 (100.0)	1,052億円 (100.0)	1,073億円 (100.0)	1,082億円 (100.0)
売上総利益	356億円 (38.1)	393億円 (37.4)	412億円 (38.4)	406億円 (37.5)
営業利益	116億円 (12.4)	144億円 (13.7)	164億円 (15.3)	318億円 (29.4)
税引前利益	125億円 (13.3)	161億円 (15.3)	171億円 (15.9)	331億円 (30.6)
当期純利益	78億円 (8.4)	102億円 (9.7)	108億円 (10.1)	197億円 (18.2)

<以下、第4四半期の厚生年金基金代行返上による影響額を除いた場合の推移>

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上総利益	356億円 (38.1)	393億円 (37.4)	412億円 (38.4)	431億円 (39.8)
営業利益	116億円 (12.4)	144億円 (13.7)	164億円 (15.3)	201億円 (18.6)

※()内の数値は売上高比

2003年度業績概況(連結)



厚生年金基金代行返上の影響

一時処理額控除後、営業利益では117億円の増益要因

(単位：百万円)

項 目	金 額
①代行返上に伴う一時処理額控除前利益	△18,000
②代行返上に伴う将来昇給影響部分返上益	△4,380
③代行返上に伴う未認識数理計算上の差異の一時認識額	10,687
代行返上に伴う一時処理額 (②+③)	6,307
(うち売上原価)	(2,489)
(うち販売費及び一般管理費)	(2,405)
(うち研究開発費)	(1,413)
代行返上に伴う営業利益影響額合計 (①+②+③)	△11,693

※上表において、マイナスは利益増加要因、プラスは利益減少要因

2004年度業績予想（連結）

	2004年度 上期	2004年度 下期	2004年度 通期
売上高	2,220億円 (+11.7%)	2,180億円 (+1.1%)	4,400億円 (+6.2%)
営業利益	400億円 (+53.8%)	380億円 (▲21.2%)	780億円 (+5.1%)
税引前利益	410億円 (+43.6%)	390億円 (▲22.2%)	800億円 (+1.7%)
当期純利益	260億円 (+44.4%)	250億円 (▲18.1%)	510億円 (+5.1%)

<以下、前期の厚生年金基金代行返上による影響額を除いた場合の伸び率>

	2004年度 上期	2004年度 下期	2004年度 通期
営業利益	(+53.8%)	(+4.1%)	(+24.8%)
税引前利益	(+43.6%)	(+1.4%)	(+19.4%)

※1 [四半期別売上高]Q1:1,120億円、Q2:1,100億円、Q3:1,100億円、Q4:1,080億円

※2 ()は、半期は前年同期比伸び率、通期は前期比伸び率

2004年度業績予想（連結）

品種別・用途別売上予想

品種	前期比
コンデンサ	+10%程度
抵抗器	横ばい
圧電製品	横ばい
高周波デバイス	+5~10%
モジュール製品	+5%程度
その他製品	+10~15%
合計	+6.2%

用途	前期比
通信 (内携帯電話)	+5~10% (+5%程度)
EDP・その他	0~+5%
民生用電子機器	+5%程度
家電・その他	+5~10%
合計	+6.2%

設備投資の推移(連結)

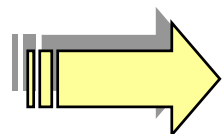
<過去2~3年>

- 生産コスト低減の合理化投資
- 新製品増強のための投資
- 研究開発投資

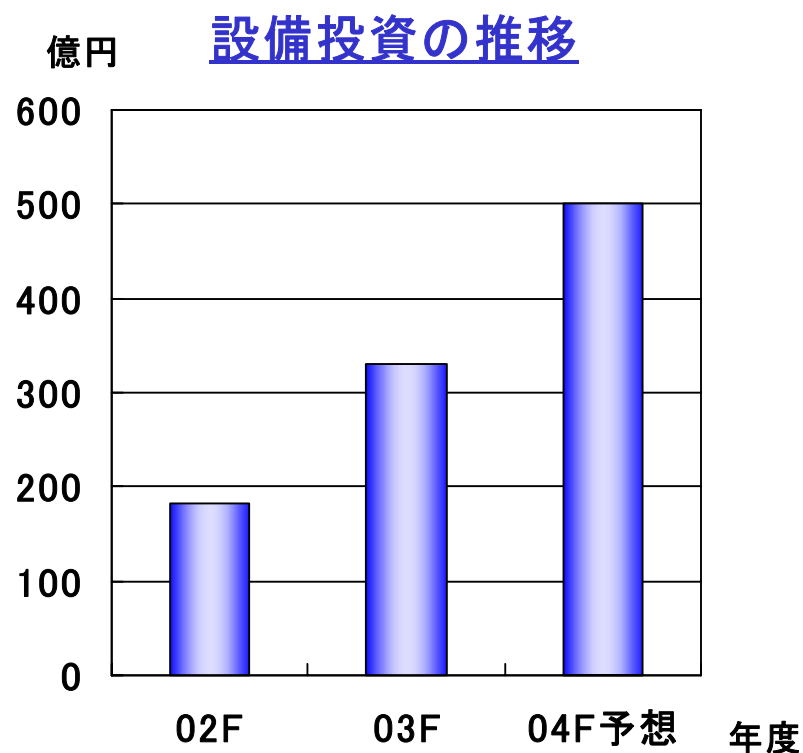
などを中心に実施

<2004年度予想>

- 上記に加え、
需要が拡大している主力製品に
対する生産能力増強投資を実施

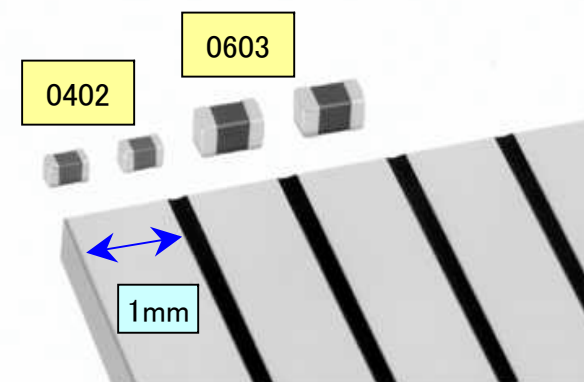


前期比51%増の500億円



小型品：電子機器の小型化、高機能化により需要拡大

- 0603サイズ
 - 売上数量が大幅増
 - 2003年度：前期比で2.0倍以上
- 0402サイズ
 - 2003年11月に商品化
 - 0603に比べ面積で半分以下、体積で7割減の小型化を実現
 - 数年後には携帯電話のメインボードへの搭載が期待される



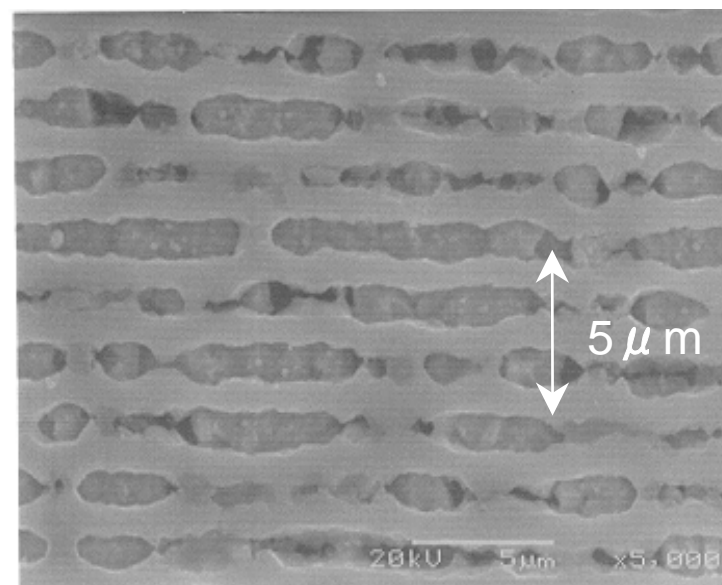
0.4 × 0.2mm、0.6 × 0.3mmサイズ
セラミックコンデンサ

大容量品：薄層化技術で商品戦列を拡充

- 超微粒子技術・高分散化技術により $1.0\ \mu\text{m}$ 薄層誘電体を開発
 - 2012サイズ $22\ \mu\text{F}$ 品を商品化
 - $10\ \mu\text{F}$ 領域で世界最小サイズの1608サイズ品を商品化

小型大容量品の製品群を拡充

1 μm 素子厚断面



- 異種コンデンサからセラミックコンデンサへの置き換え
- 急速に小型化、高機能化が進んでいるモバイル機器、パソコン、デジタルAV機器での需要拡大

用途特化型：多様な用途の商品を開発

- MPU向けの低ESLコンデンサ
 - MPU高周波化に対応
 - 技術の蓄積と供給体制の構築で先行
- その他の用途特化型コンデンサ
 - コンデンサアレイ(多連電極)
(携帯電話向け、デジタルスチルカメラ向けで需要拡大)
 - 自動車電装用コンデンサ
 - 電源用コンデンサ

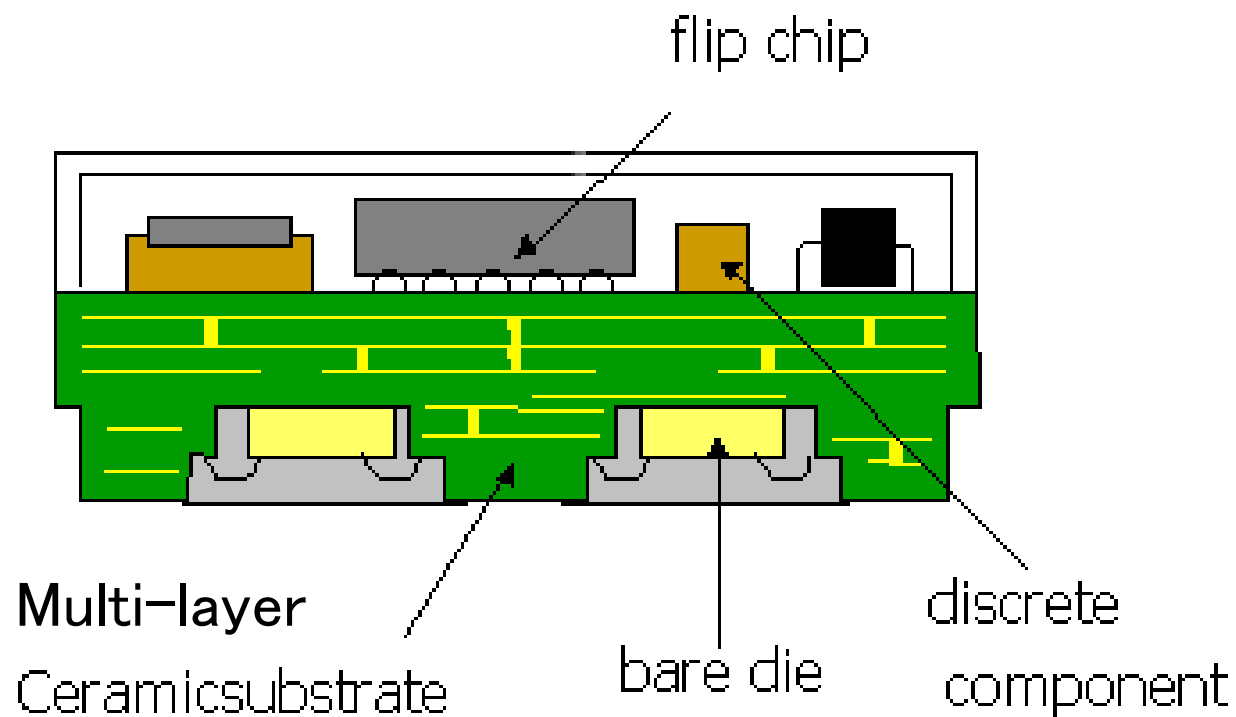
セラミック多層モジュール

- デザイン・イン活動の強化
 - 携帯電話の高機能化、多機能化に伴なう得意先のモジュール調達志向に対応
 - GSMからPDC・W-CDMAへの事業範囲の拡大
 - 部品機能の複合化による付加価値の向上
- スイッチプレクサ
 - 現在、表面波フィルタを搭載した製品が拡大
 - 将来的にはパワーアンプ機能を含めてフロントエンド部分を一体化する見通し
- 利益率向上への取り組み
 - LTCCなど原材料を内製化している製品に注力
 - 基板に自社のチップ部品を搭載

- Bluetooth[®] 市場
 - 欧州でBluetooth[®] 搭載の携帯電話とワイヤレスヘッドセットの組み合わせで立ち上がる
 - 今後は自動車のハンズフリーシステムの拡大に合わせて携帯電話への搭載が進むことが期待される
- Bluetooth[®] モジュール
 - 当社の主力市場は携帯電話向け
 - 小型化のメリットを生かした低温焼結セラミックス(LTCC)を用いた製品を拡大

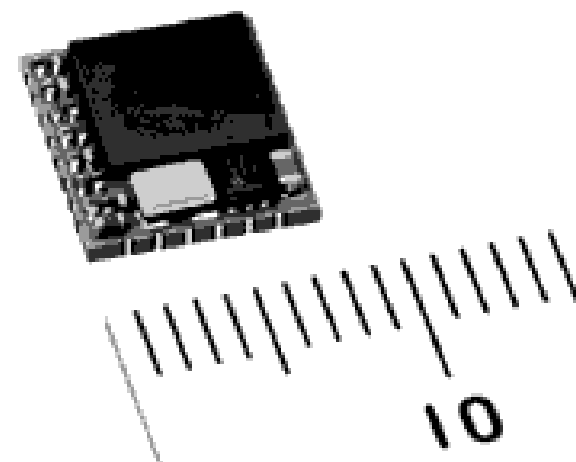
(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です

<構造図>



<写真>

(LMBTB044)



携帯端末の高機能化・複合化に対応した 表面波フィルタの小型化・複合化

• 小型化対応

- フリップチップ実装技術を確立
(圧電基板とセラミックパッケージの bumps を直接接合)
- チップサイズパッケージ技術を応用した表面波フィルタを商品化



積層セラミックパッケージワイヤボンダタイプ

サイズ: 3.0mm × 3.0mm以上

積層セラミックパッケージフリップチップタイプ

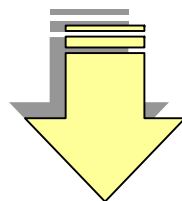
2.5mm × 2.0mm (シングル)

CSPフリップチップタイプ

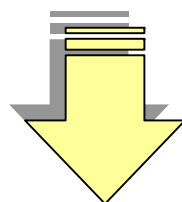
2.0mm × 1.6mm (シングル)

- 複合化対応
 - CDMA800／TDMA用、2GHz帯のW-CDMA用の表面波デュプレクサを商品化、量産
(携帯電話の送信部と受信部の2つのRFフィルタを1つにパッケージ)
- 技術領域の拡大と商品戦列の拡充
 - 2003年6月、沖電気工業(株)より表面波デュプレクサ事業の知的財産権・人的資源を獲得

電子機器のデジタル化、高機能化に伴ない、
ICの集積化と信号周波数の高速化が進行



誤動作、受信障害、ノイズ増大などの問題



ノイズ対策製品の需要が急拡大

ノイズ対策部品ラインアップ

- チップインダクタ (BLM)

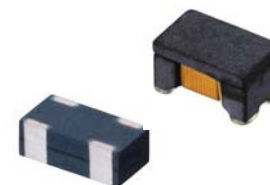
- チップ積層セラミックコンデンサで培った材料技術、生産技術を水平展開し、小型化 (0603-1005サイズ) を推進するとともに、コスト競争力を強化



BLM Series

- チップコモンモードチョークコイル (DCC)

- 高速インターフェースで発生するノイズを効果的に除去



DLP/DLW31S Series

ノイズ対策部品ラインアップ

- チップ3端子型コンデンサ (NFM)
 - デジタルAV機器のIC高速化により増加している電源ラインのノイズ対策に特性を発揮



NFM21P Series

- チップコイル (LQW/LQG/LQP)
 - 携帯電話向けの高周波コイル、電源回路の薄型コイルで需要拡大



LQW/LQG/LQP Series

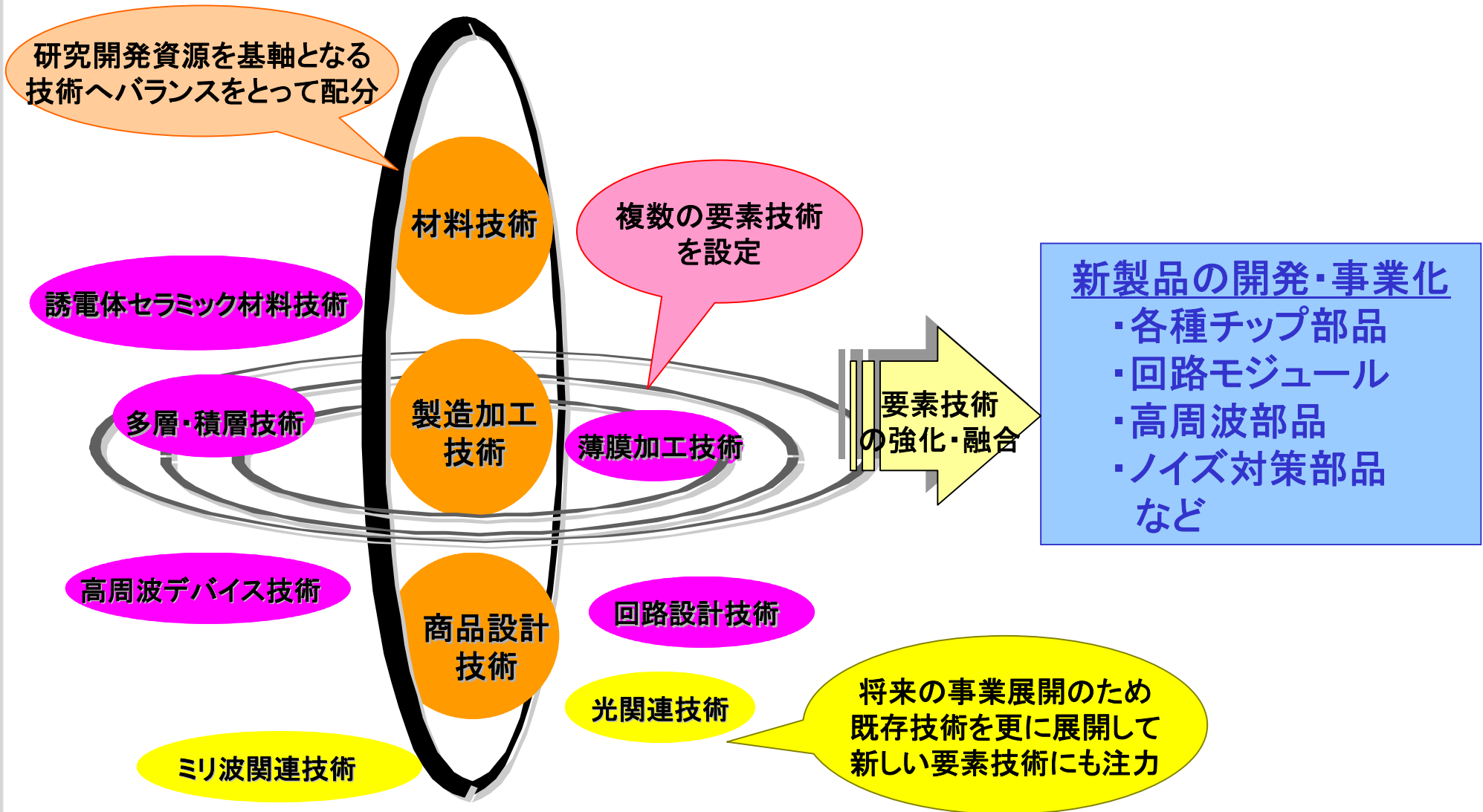
- 回路設計技術、生産技術により、省エネルギーで効率が高く、小型、薄型の電源を製品化
- 従来、FAXやコピー機向けを中心に電源事業に取り組む
- 市場が拡大しているPDPや液晶ディスプレイなどのデジタル機器向けで売上が伸長

デジタルAV機器の需要拡大を見込み、電源事業を強化

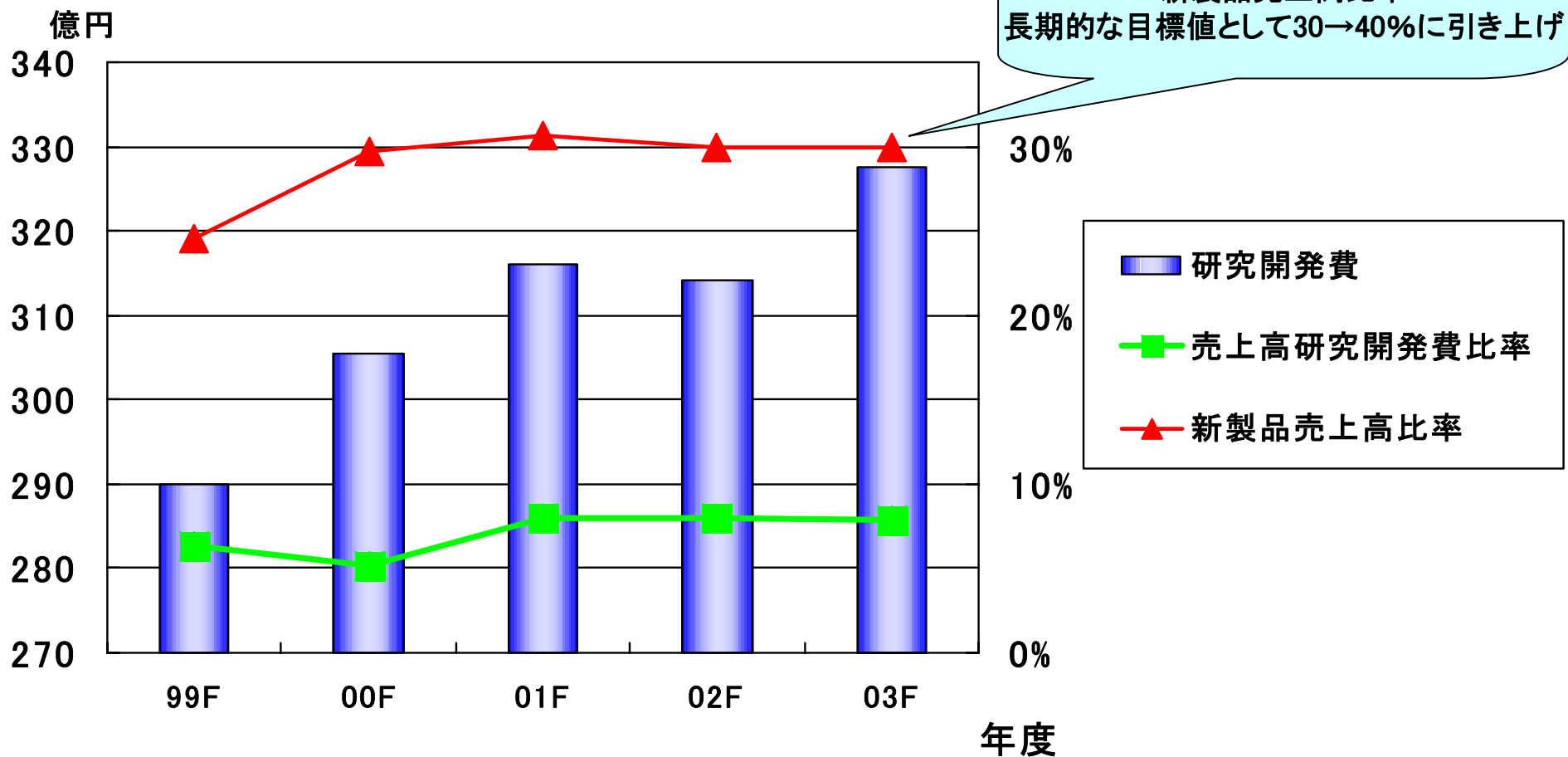
- ジャイロスター
 - デジタルビデオカメラの手ブレ補正用で売上が伸長
 - デジタルスチルカメラの高級機種で採用が拡大
- ショックセンサ
 - エアバックセンサー向け
 - HDDの振動検知用に売上が伸長
(HDDはパソコン向けに加え、
DVDレコーダ、携帯型音楽プレーヤ向けなどで需要が拡大)

圧電、磁気、焦電などのセラミック材料技術を活用し、
独創的なセンサ関連製品を開発

研究開発活動



研究開発費の推移(連結)



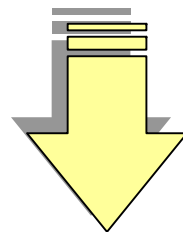
※上表の2003年度研究開発費は、厚生年金基金代行返上による一時処理額14億円を除いている。

- 生産体制

- 日本、中国での生産能力を拡充
- アメリカ、ドイツの生産拠点を撤収

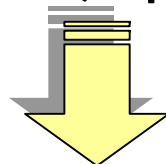
- 販売体制

- 需要の伸びが期待できる東アジア地域の販売体制を強化



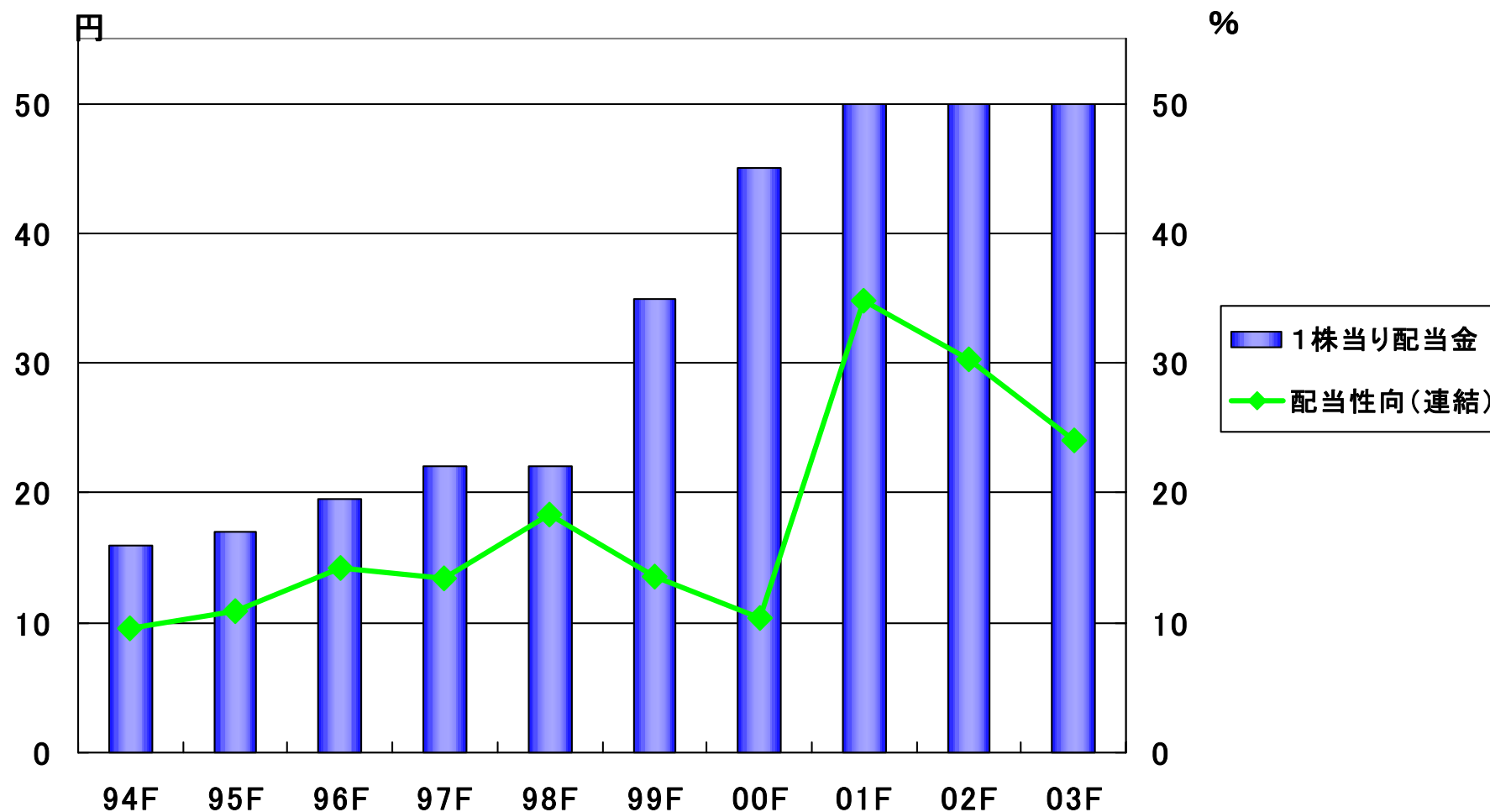
グローバルな観点で経営資源配分を適正化

- M&Aの対象
 - 当社の技術との相乗効果がある技術
 - 販売チャネルを有効活用できる電子部品事業
- (株)住友金属エレクトロデバイスよりLTCC基板事業を譲受
 - 「セラミック材料技術」「無収縮焼成技術」「キャビティ形成技術」などの特徴ある技術
 - 自動車のエンジンコントロール部分に用いるセラミック基板



自動車電装向け事業の強化
新たなLTCCを応用した製品の事業展開

配当の推移

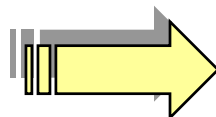


1株当り配当金 98年度:22円 → 現在:50円

自己株式取得

- 商法第210条の規定に基づく自己株式取得

	<u>取得株数</u>	<u>取得総額</u>
2002年6月～2003年6月	1,000万株	533億円
2003年6月～2004年6月	506万株	300億円



2003年9月に1,000万株を消却

- 商法第211条の3第1項第2号の規定を適用するため、
当定時株主総会で定款を変更

定款により自己株式取得枠の設定を取締役会へ授権

当社の見通し、戦略、判断などのうち、歴史的事実でないものは資料作成時点で入手可能な情報から得られた当社の経営陣の判断に基づいております。従って、その実現にはさまざまな不確定要素が含まれておりますので、これらの情報に全面的に依拠することは控えて頂くようお願い致します。

また、当社はこれらの資料を現時点での最新情報に更新する義務を負っておりません。

